

公司代码：688655

公司简称：迅捷兴

深圳市迅捷兴科技股份有限公司
2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2021 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 64,075,348.41 元。经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司 2021 年度利润分配预案为：

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元(含税)，截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 13,339 万股，以此为基数计算，预计派发现金红利总额为 10,004,250.00 元，占公司 2021 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 15.61%，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金红利金额不变，相应调整分配总额；该利润分配预案尚需提交股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	迅捷兴	688655	无

公司存托凭证简况

适用 不适用

联系人和联系方式

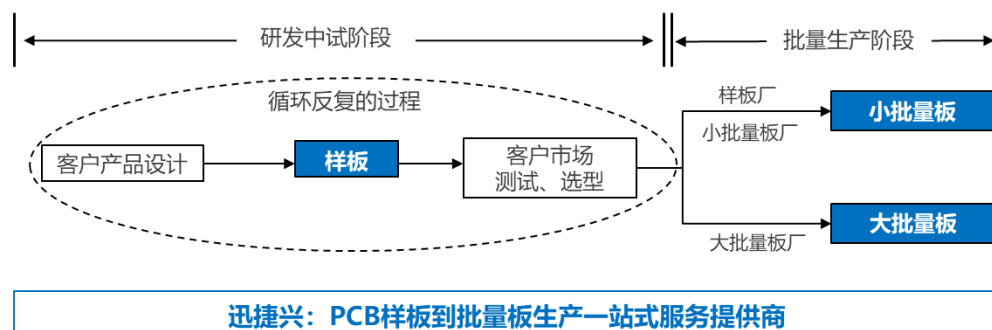
联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	吴玉梅	许良
办公地址	深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋	深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋
电话	0755-33653366	0755-33653366
电子信箱	zqb@jxpcb.com	zqb@jxpcb.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

(1) 主要业务

公司主营业务为印制电路板（PCB）的研发、生产与销售，产品和服务以“多品种、小批量、高层次、短交期”为特色，致力于满足客户产品生命周期各阶段的需求，提供从样板生产到批量板生产的一站式服务，满足客户从新产品开发至最终定型量产的 PCB 需求。



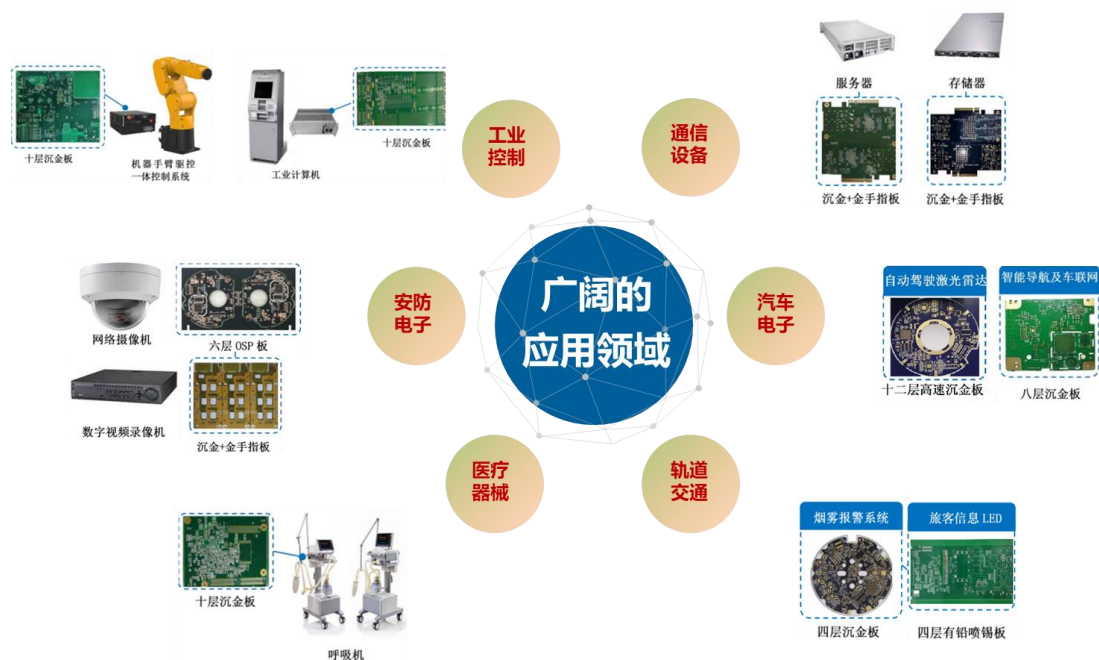
公司起步于样板，经过多年在 PCB 样板领域的深耕，公司积累了大量的客户资源、成熟的工艺技术。为了更好的服务于样板客户产品研发成功后的批量阶段的需求，配合客户批量订单的导

入，公司在业务上做出了自然的延伸，于 2016 年底顺利实现向“样板到批量生产一站式服务模式”演变，为公司未来发展开拓了更广阔的发展空间。

目前，国内 PCB 企业多以大批量业务为主，专注于样板业务的企业较少。公司业务涵盖样板、小批量板和大批量板，是行业内为数不多可以提供从样板到批量生产一站式服务的 PCB 企业。

(2) 公司产品及其用途

公司技术能力全面，产品种类丰富。可根据客户需求提供多样化的产品，种类覆盖了 HDI 板、高频板、高速板、厚铜板、金属基板、挠性板、刚挠结合板等多种特殊工艺和特殊基材产品。公司产品广泛应用于安防电子、工业控制、通信设备、医疗器械、汽车电子、轨道交通等领域。安防电子领域，公司产品主要应用于监控摄像头、热成像仪、人脸识别一体机、数字视频录像机等；工业控制领域，公司产品主要应用于交流伺服系统、机器人手臂驱控一体控制系统、工业计算机等；通信设备领域，公司产品主要应用于 5G 天线、基站设备、服务器、交换机、存储器、滤波器、功放器、移项器、光电模块、路由器、连接器等；医疗器械领域，公司产品主要应用于呼吸机、监护仪、血糖仪、血氧机、除颤仪、心电诊断仪器、影像诊断设备等；汽车电子领域，公司产品主要应用于自动驾驶雷达、智能影音系统、自动驾驶监控系统、尾气排放检测、智能导航及车联网等；轨道交通领域，公司产品主要应用于烟雾报警系统、车外窗显示系统、继电器等。



(二) 主要经营模式

(1) 采购模式

公司产品涵盖 PCB 样板和批量板，生产所需原材料的规格、型号、品种较多，因此公司原材料采购具有采购频率高、单次采购量小、品类多的特点。公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、金盐、铜箔、铜球、干膜、油墨等。通常情况下，公司主要原材料向制造商直接采购，其他品种多、采购量小的辅材则主要通过贸易商采购。对于常备物料，公司在保证安全库存的前提下，按生产计划安排采购；对于非常备物料，公司按实际生产需求安排采购。

为保证原材料采购的品质、交期的稳定性，规避采购风险，公司制定了《供方评定控制程序》，对供应商的开发、管理、评审进行规范。

(2) 生产模式

公司 PCB 样板和批量板均采用按订单生产的模式。其中 PCB 批量板针对的是新产品定型后的批量生产阶段，单个品种的需求量较大，生产主要体现为制板过程，定价依据主要体现为制板费。而 PCB 样板针对的是新产品定型前的研发、中试阶段，单个品种的需求量小，在线品种多，对公司柔性化生产管理能力要求较高。PCB 样板的生产过程既包括制板过程，也包括工程处理、模具制作等非制板过程。生产流程如下：

营销中心在接到客户订单后，将客户技术文件交由工程部进行订单预审，识别常规订单和非常规订单。通常情况下，客户提供的设计文件需经公司工程技术人员审查、补正、优化，并转换成工程文件后，才可编制用于生产指导的制造说明。

计划部根据制造说明、出货需求、样品需求、以及客户的交期，依据原材料库存情况、工序产量目标及生产周期一览表编制每日生产作业计划，并分发给工程部、物控部、品质部、生产部各工序。

生产部管理人员通过生产流程卡、作业指导书等内容得到拟生产产品的特性信息，并依照工艺流程、作业指导书等实施生产工艺排序和作业准备，同时确保生产用原材料、辅料等器材与要求一致。

生产部根据生产排程表进行生产，并对生产过程进行记录，保证过程可追溯性。

(3) 销售模式

公司采取“向下游制造商直接销售为主、通过贸易商销售为辅”的销售模式。公司一般与主要客户签定框架性买卖合同，约定产品的质量标准和交货方式、结算方式等；在合同期内，客户按需向公司发出具体采购订单，并约定具体技术要求，销售价格、数量等。

公司销售分为国内销售和出口销售。为了快速响应客户需求，公司国内销售以直销为主，主要区域为华南和华东。公司出口销售主要通过贸易商进行，出口销售国家主要包括德国、英国、

美国等。

(4) 研发模式

技术中心根据公司经营计划并结合行业前沿技术发展方向制订研发计划，经详细的技术、市场、产品等方面的调研后拟定研发项目。技术中心根据研发项目的难易程度，分步骤、分时段、分人员进行不同研发项目之间的统筹安排。公司研发流程分为立项阶段、方案阶段、试样阶段和批量阶段四个阶段。研发项目实施过程中，技术中心对新工艺流程进行梳理并形成技术规范文件；研发项目结项通过后，公司及时启动专利申请对知识产权进行保护。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1) 所处行业

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所处行业属于“398 电子元件及电子专用材料制造”之“3982 电子电路制造”。根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所处行业为“制造业”之“计算机、通信和其他电子设备制造业(代码 C39)”。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类(2018)》，公司业务属于“1.新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”。

(2) 行业发展阶段及基本特点

印制电路板(简称“PCB”)是电子产品的关键电子互连件，几乎每种电子设备都离不开 PCB，有“电子产品之母”之称。作为电子终端设备不可或缺的组件，PCB 产业的发展水平在一定程度上体现了国家或地区电子信息产业发展的速度与技术水平。

① 整体行业发展情况

PCB 行业是全球电子元件细分产业中产值占比最大的产业，全球电子信息产业的长足发展壮大了产业规模，也大力推动 PCB 行业的整体发展，无论是传统行业还是新兴产业都将从中受益。根据 PrismaMark 预测，未来五年全球 PCB 行业产值将持续稳定增长，预计 2020 年至 2024 年复合增长率为 4.3%，2024 年全球 PCB 行业产值将达到 758.46 亿美元。PCB 作为基础电子元件，势必随着下游终端的持续向好趋势，需求持续提升。

受益于全球 PCB 产能向中国转移以及下游蓬勃发展的电子终端产品制造的影响，中国已成为全球第一大 PCB 制造基地。根据 PrismaMark 预测，未来 5 年亚洲将继续主导全球 PCB 市场的发展，而中国的核心地位更加稳固，在国内电子信息产业的带动下，中国大陆地区 PCB 行业将保持 4.9% 的复合增长率，至 2024 年行业总产值将达到 417.70 亿美元。

印制电路板的下游行业广泛，包括通信、消费电子、计算机、网络设备、工业控制、汽车电子、航空、医疗等。广泛的应用分布为印制电路板行业提供巨大的市场空间，降低了行业发展的风险。下游行业的发展是 PCB 产业增长的动力，因为下游应用行业存量市场规模的稳定增长为 PCB 行业发展提供了基础，同时下游行业的技术革新也为 PCB 行业带来了增量应用市场的快速发展。

② 样板、小批量行业情况

PCB 产品按照均单面积进行分类可分为样板、小批量板和大批量板。样板、小批量板及大批量板特点主要区分如下：

项目	样板	小批量板	大批量板
应用领域	各应用领域的研发阶段	工业控制、汽车电子、通信设备、医疗器械等	计算机、通信终端、消费电子、汽车电子等
平均订单面积	5 平方米以下	5~50 平方米	50 平方米以上
订单量	订单数量多、产品种类多	订单数量较多、产品种类较多	订单数量少、产品种类少
工程处理	工程技术人员多，快速处理能力要求高	工程技术人员较多，快速处理能力要求较高	客户产品已定型，对快速处理能力要求不高
生产管理	管理要求高，生产柔性化要求高	管理要求高，生产柔性化要求高	大批量生产，生产柔性化要求相对较低
交货期	一般 10 天以内	一般 10~20 天	一般 20 天以上
快速响应	快速响应要求高	快速响应要求较高	快速响应要求低
客户维护	客户多、售后服务要求最高	客户较少，售后服务要求较样板较低	客户较少，售后服务要求较样板较低
毛利率	高	较高	一般低于样板、小批量板

根据 Prismark 的数据显示，样板产值规模约占 PCB 整体产值规模的 5%，小批量板产值规模约占 PCB 整体产值规模的 10%-15%。

(3) 主要技术门槛

PCB 行业属于技术密集型行业，制造工艺复杂，工艺流程涵盖钻孔、电镀、蚀刻、阻焊等多道工序，涉及到材料、电子、机械、光学、化工等多学科技术，需要 PCB 制造企业具备较强的工艺技术。

PCB 应用领域细分行业众多，产品种类亦十分繁杂，应用于不同领域或相同领域不同功能的 PCB 产品的技术要求差异较大，需要根据客户定制化要求进行生产及提供解决方案。PCB 企业的工艺技术水平不仅取决于生产设备的配置，更来源于企业生产经验和技术的不断积累。随着电子产品日益朝智能化、轻薄化、精密化方向发展，其对于 PCB 产品的技术先进性及稳定性要求日益提高，生产企业必须拥有先进的生产设备、精湛的生产工艺及不断创新的生产技术以应对

行业的不断技术革新。因此，进入 PCB 行业的技术壁垒将日益提高。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

根据 CPCA 公布的《第二十届中国电子电路行业排行榜》，内资 PCB 百强企业中，公司排名 66 位，并进入中国综合 PCB 百强企业，同时公司在专业从事样板和小批量板的细分领域企业中位居前列。

目前，国内 PCB 企业多以大批量业务为主，专注于样板业务的企业较少，而从样板向批量板生产一站式服务模式延伸的企业更是屈指可数。公司经过多年在 PCB 样板领域的深耕，积累了大量的客户资源、成熟的工艺技术和充足的资金实力。为了更好的服务于样板客户产品研发成功后的批量阶段的需求，配合客户批量订单的导入，公司在业务上做出了自然的延伸，从“单一样板生产”向“样板到批量生产一站式服务模式”演变。

报告期，公司坚持走特色化发展路线，持续布局从样板生产到批量板生产一站式服务，利用样板、小批量板领域前期积累的丰富技术经验和客户资源，深挖原有大客户需求，并积极拓展新能源汽车、储能、5G 通讯、物联网、人工智能等领域，为公司未来的发展开拓了更广阔的市场空间，并进一步提高了公司市场占有率。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）新一代信息技术驱动PCB行业进入新的发展周期

当前，全球新一轮科技革命和产业变革正在孕育兴起，云计算、大数据、人工智能、物联网等新技术、新应用不断涌现、发展。随着5G网络建设的大规模推进及商用，将催化电子产品相关技术和应用更快发展、迭代、融合。由于5G通信基站建设量大幅增加，应用于5G网络的交换机、路由器、光传送网等通信设备对PCB的需求增加，PCB使用量将相应增长；在通信代际更迭、数据流量爆发式增长的背景下，高速、大容量、高性能的服务器将不断发展，将会对高层数、高密度、高频高速印制电路板形成大量需求；随着电动汽车普及率提高、汽车电子化程度加深、先进驾驶辅助系统(ADAS)的渗透率正在提高以及自动驾驶技术和汽车网联化的不断发展，叠加新能源汽车未来发展趋势，汽车不仅对PCB用量大幅提升，对高端PCB的需求也在迅速增长。为此，未来云计算、5G、物联网、汽车电子等新一代信息技术将成为引领经济发展的引擎，将驱动PCB行业进入新一轮发展周期。

（2）PCB产品将向高密度化、高性能化和环保化方向发展

PCB行业的发展方向取决于下游电子终端产品的发展方向。随着电子产品的日益普及，包括医疗电子、可穿戴设备等在内的新型产品向轻、薄、小方向发展，对印制电路板的精细度和稳定

性都提出了更高的要求，高密度化、高性能化是未来印制电路板的发展方向。高密度化对电路板孔径大小、布线宽度、层数高低等方面提出较高的要求，高密度互连技术（HDI）正是当今PCB先进技术的体现。高性能化主要针对PCB提高阻抗性和散热性等方面的性能，也是增强产品的可靠性的关键。全球PCB产业不断重视环境保护与清洁生产，除了在日常生产中规范污染物处理并创建清洁生产模式，使用新型环保材料、提高工艺技术从而制造出节能环保的新型产品也将成为PCB行业的发展方向。

① 高密度化

高密度化是未来印制电路板技术发展的重要方向。高密度化，主要是指对印制电路板孔径的大小、布线的宽窄、层数的高低等方面的要求，即HDI技术。目前，孔径可做到50 μm ，甚至更小。线宽线距基本可做到50 μm ，甚至25 μm ，即常说细微电路化。层厚可以做得更薄，可以做到30 μm 。表面方面，随着PCB的层数提高，对降低翘曲度要求不断提高，对于高多层产品，已从1%降低到0.5%。

② 高性能化

高性能化主要是指PCB产品高阻抗性和散热性等方面的性能，从而保证信息稳定有效传输。现代电子产品对信息传输速率要求更快、信息传送量更大。伴随着数字传输信号日益高频化，唯有具备良好的阻抗性才能保障信息的有效传输，相应的埋电阻和埋电容技术是未来的重要技术方向。PCB产品电路阻抗越低，其性能就越稳定，越可实现高频高速工作，承担更复杂的功能。高速高频、多功能、大容量是电子技术发展的必然趋势。在此情况下，铝基板、厚铜板等高导热金属基板得到广泛应用，高频板、光电板等特殊功能或工艺的产品研发受到越来越多关注。

③ 环保化

PCB行业生产工序多、工艺复杂，消耗原材料种类众多，涉及到重金属污染源，同时需要耗用大量的资源和能源，产生的废弃物处理难度较大。目前，随着全球生态环境问题的日渐突出，绿色环保的理念在电子产业中已成为共识。PCB行业生产工艺复杂，工序中涉及到重金属污染源，另外也需要耗用大量的资源和能源。因此，考虑PCB行业可持续发展的需要，未来PCB的加工制作和产品将向环保方面发展。比如说，目前广泛应用的PCB生产方法是“减成法”，通过蚀刻等工序形成产品，而未来可能会开发“加成法”，直接在绝缘基材上制作电路，既能节省原料而且环保。未来的PCB产品的材料和工艺也将进一步向无卤无铅的绿色方面发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	850,691,150.99	581,262,580.67	46.35	480,776,947.82
归属于上市公司股东的 净资产	648,195,873.34	384,065,211.74	68.77	327,521,725.90
营业收入	564,067,210.66	447,543,182.58	26.04	388,082,843.53
归属于上市公司股东的 净利润	64,075,348.41	56,490,069.15	13.43	35,244,298.86
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	58,077,389.73	49,739,122.17	16.76	34,132,478.31
经营活动产生的现金流 量净额	85,349,442.37	54,408,355.81	56.87	-3,211,178.04
加权平均净资产收益率 (%)	11.66	15.88	减少4.22个 百分点	11.37
基本每股收益(元/股)	0.52	0.56	-7.14	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.56	-7.14	0.35
研发投入占营业收入的 比例(%)	6.58	6.34	增加0.24个 百分点	7.53

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	122,525,329.51	164,102,913.04	153,210,943.82	124,228,024.29
归属于上市公司股东的 净利润	14,291,321.26	21,665,067.62	21,125,885.69	6,993,073.84
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 后的净利润	13,655,575.22	20,796,493.13	18,759,279.33	4,866,042.05
经营活动产生的现金 流量净额	-2,094,690.96	28,703,226.35	32,811,628.38	25,929,278.60

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	7,161
------------------	-------

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								6,420
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)								0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)								0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)								0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)								0
前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押、标记或 冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
马卓	0	51,573,100	38.66	51,573,100	51,573,100	无	0	境内 自然 人
联讯德威	0	7,263,900	5.45	7,263,900	7,263,900	无	0	其他
粤开资本(SS)	0	4,999,400	3.75	4,999,400	4,999,400	无	0	国有 法人
杨春光	0	3,807,200	2.85	3,807,200	3,807,200	无	0	其他
人才二号基金	0	3,789,900	2.84	3,789,900	3,789,900	无	0	其他
瑞宏凯银	0	3,789,500	2.84	3,789,500	3,789,500	无	0	其他
华拓至远	0	3,789,500	2.84	3,789,500	3,789,500	无	0	其他
吉顺发投资	0	3,537,400	2.65	3,537,400	3,537,400	无	0	其他
李雪梅	0	3,175,100	2.38	3,175,100	3,175,100	无	0	境内 自然 人
高新投投资(SS)	0	2,905,600	2.18	2,905,600	2,905,600	无	0	国有 法人
上述股东关联关系或一 致行动的说明	上述股东中，马卓持有吉顺发 20.58%的出资额并担任执行事务合伙人，杨春光为马卓配偶之胞弟。粤开资本为联讯德威之执行事务合伙人，并持有其 15%的财产份额。深圳市高新投集团有限公司分别持有高新投投资、人才二号基金 100%股权、18%股权，深圳市高新投集团有限公司控制的公司担任人才二号基金执行事务合伙人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股 东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

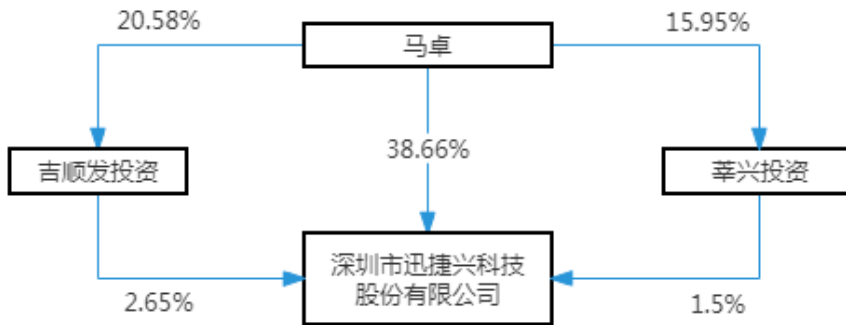
适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

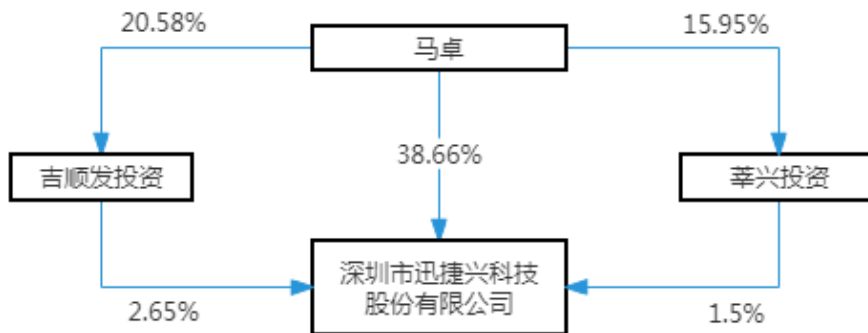
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021 年，在全球“缺芯”的大背景下，叠加原材料价格波动影响，公司积极应对各种变化，持续布局 PCB 生产从客户产品研发到批量生产一站式服务发展战略，通过进一步提升瓶颈工序产能，不断优化产品品质和交期、强化成本管控能力等进一步增强一站式服务竞争力，从而努力推动公司主营业务实现稳定增长。

报告期内，公司实现营业收入 56,406.72 万元，较上年同期增长 26.04%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,407.53 万元，较上年同期增长 13.43%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 5,807.74 万元，较上年同期增长 16.76%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用